



3855 SW 153rd Drive
Beaverton, Oregon 97006 USA
전화: 503-619-0560
팩스: 503-644-6708
이메일: admin@ocpip.org
www.ocpip.org

2011년 4월 12일 보도자료

OCP-IP, 첨단 설계에 고급 OCP 기능의 성공적인 이행 강조

오레건주 비버튼 — 2011년 4월 12일 - OCP-IP는 Texas Instruments Incorporated(TI)의 OMAP™ 4 플랫폼과 같은 혁신적인 설계에 의한 2차원(2-D) 버스트, 전력 관리를 포함한 정교한 OCP 인터페이스 기능의 성공적인 채택과 이행을 발표합니다.

집적회로(IC) 개발에 OCP를 활용함으로써 설계자들은 특정 버스 프로토콜 및 일체의 특정한 설계 이행과 독립적인 코어를 구축할 수 있습니다. 이는 다중 시스템 온 칩(SoC) 설계 전반에서 OCP에 부응하는 코어를 더 쉽게 재사용할 수 있도록 해줍니다. OCP는 코어 자체를 반복 수정할 필요를 없애며, 번거롭고 불편적으로 이해되는 방식으로 제시될 수 있는 모든 코어의 자연스러운 인터페이스 기능을 규정함으로써 완전히 재사용 가능한 검증 및 테스트 벤치를 보존합니다.

최소의 전력 소모로 최대의 메모리 시스템 성능을 요구하는 가장 정교한 임베디드 멀티미디어 및 그래픽 프로세서를 위해 OCP 프로토콜은 2-D 버스트, 전력 관리를 위한 안전한 코어 연결/차단 등의 기능을 제공합니다. 고급 2-D 버스트 기능은 고급 그래픽 이행을 위한 최고 메모리 시스템 성능을 보장하며, 전력 관리 기능은 전력 관리 하드웨어가 일체의 트랜잭션의 손실 없이 OCP 인터페이스를 연결 해제할 수 있게 하여 관리자가 독립적으로 전력 공급을 차단할 수 있는 새로운 연결 프로토콜을 규정합니다. [2-D 버스팅과 전력 관리](#)의 사용에 관해 자세히 설명하는 기술 자료는 제공된 링크를 클릭하여 확인하실 수 있습니다.

OCP 프로토콜의 이처럼 정교한 프로토콜 기능을 사용하는 첫 번째 주요 SoC 제품이 지금 시판되고 있습니다.

“TI의 OMAP 4 플랫폼은 OCP의 2-D 버스트 기능이 동영상과 스틸 이미지 프로세싱을 위한 DRAM 효율을 향상시키도록 돕습니다. 코어 차단, 비순차적 트랜잭션 완료 및 단일 요청 다중 데이터(single-request-multiple-data: SRMD)와 같은 기타 OCP 기능 역시 OMAP 4 기술에 혜택을 준다”고 TI 무선 사업부의 MPU 및 DRAM 아키텍처 분야 리더인 James Aldis는 말했습니다. “이러한 OCP 컴포넌트는 OMAP 4 응용 프로세서를 업계 최고급 모바일 멀티미디어 플랫폼으로 만드는 높은 성능과 낮은 전력 용량을 구현하는 데 중요한 역할을 수행합니다.”

OMAP 4 플랫폼은 OCP 인터페이스를 활용하는 TI의 4세대 OMAP입니다.

OMAP4430 프로세서는 OCP에 부응하는 100개 이상의 구성요소들을 포함합니다.

TI는 OCP-IP의 집행운영위원회 회원입니다.

“OCP-IP는 OCP 사양을 제공할 뿐 아니라, 우리 회원들이 OMAP 플랫폼과 같은 세계 최상급 첨단 설계에 OCP를 빠르고 쉽게 이행할 수 있게 해주는 완벽한 인프라를 제공하기도 한다”고 OCP-IP의 Ian Mackintosh 사장은 말했습니다.

“표준은 오직 현실 세계의 이행을 통해서만 입증되며, 우리의 회원사들은 OCP를 채택하여 이를 생산 SoC 설계에 적용하여 연간 대략 10억 대를 출고했습니다.”

OCP가 사용되는 많은 응용 분야 중 일부를 검토하시려면,

http://www.ocpip.org/ocp_inside.php에 나온 프레젠테이션을 참조하십시오.

OCP-IP에 대한 최신 정보는 <http://www.ocpip.org/newsletters.php>에서 뉴스레터를 참조하십시오

OCP-IP에 대한 정보

2001년 설립된 OCP-IP는 비영리 법인으로, **이종 멀티코어 시스템의 통합 요건을 포괄적으로 충족시키는 유일하게 공개 라이선스를 승인받은 코어 중심 프로토콜을** 촉진하고, 지원하며, 전달합니다. **오픈 코어 프로토콜(OCP)**은 IP 코어 재사용성을

촉진하고, 포괄적인 지원 인프라를 제공함으로써 모든 SoC 및 전자 설계의 설계
시간, 위험 및 생산비용을 절감합니다. 추가 배경지식 및 회원 정보는
www.OCPiP.org에서 검색할 수 있습니다.

추가 정보가 필요하시면 다음으로 연락하십시오.

Ian Mackintosh, OCP-IP
408-761-5980
ian@ocpip.org

Joe Basques, OCP-IP
512-551-3377
joe@ocpip.org

주의: 모든 상표 및 서비스 마크는 각 소유주의 재산입니다.

###